



213 錫鉛保護劑

§ 產品說明

213 錫鉛保護劑，用於 PCB 外層乾膜剝除專門的添加劑，可以保護錫鉛鍍層，減少 NaOH 攻擊側蝕，也不會攻擊銅面，剝膜過程銅面不易氧化，對於外層板剝膜可減少銅面氧化造成蝕銅不淨，甚至也可有效加速乾膜剝離。尤其更適用高密度板子，如 HDI、CSP 等細線路、窄間距之高級板。

§ 物 性

外觀	無色~淡黃色液體
比重	1.005 ± 0.025
OH ⁻	3.6 ~ 4.2 N
PH	> 9
閃點	> 100 °C

§ 操作條件

213 錫鉛保護劑	1~3%
NaOH	3~6%by wt
H ₂ O	加到液位線
溫 度	50~56°C
攪 拌	需 要
過 濾	連續攪拌